

И.Д. Багбая

НЕЛИНЕЙНАЯ МОДУЛЯЦИЯ ИМПУЛЬСОВ И ПУЧКОВ СВЧ РАДИОВОЛН

Настоящая работа посвящена комплексу управляемых процессов теплового взаимодействия СВЧ радиоволн со столкновительной плазмой полупроводников n-типа. Такие процессы связаны с температурной зависимостью частоты электрон-фононных столкновений ν_e в полупроводниках. Зависимость коэффициентов отражения и прохождения радиоволн в ГГц диапазоне от частоты столкновений ν_e указывает на возможность температурного контроля этих коэффициентов. Различные тенденции такой зависимости могут быть обусловлены как температурным ростом частоты ν_e , характерном, например, для Ge [1]:

$$\nu_e = \nu_{eo} \sqrt{\frac{T_e}{T_{ev}}} , \quad (1)$$

так и убыванием ν_e по закону

$$\nu_e = \nu_{eo} \sqrt{\frac{T_{eo}}{T_e}} , \quad (2)$$

отмеченному для InSb [2].

Здесь ν_{eo} - значение при начальной температуре T_{eo} , T_e - температура нагрева, так что $T_e \geq T_{eo}$.

Сочетание этих тенденций с эффектами теплового самовозбуждения волны накачки и взаимодействия двух волн типа кроссмодуляции указывает на разнообразные варианты амплитудной и частотно-фазовой модуляции СВЧ радиоволн с помощью температурных эффектов.

Следует отметить физические особенности рассматриваемых явлений, отличающие их от кроссмодуляции в газовой плазме [3, 4].

1. Наличие резкой границы полупроводниковой плазмы с внешней средой указывает на своеобразную зависимость амплитуды и фазы отраженного сигнала от электронной температуры полупроводника n-типа. Эта зависимость различна для волн s- и p-поляризаций, падающих на поверхность заданного полупроводника.

2. В ГГц диапазоне радиоволн мнимая часть диэлектрической проницаемости полупроводника ϵ может быть не мала в сравнении с ее действительной частью. При этом тепловая перестройка преломленной волны развивается в тонком слое полупроводниковой плазмы, толщина которого может быть порядка длины волны.

3. Характерное время рассматриваемых процессов определяется временем релаксации электронной температуры

$$\tau_T = \frac{1}{\delta v_e} , \quad (3)$$

где:

δ - средняя доля энергии, переданная при электрон-фононном столкновении, $\delta = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \cdot \frac{m_e \cdot c_s^2}{k T e_0}$. (4)

Здесь c_s - скорость звука, m_e - эффективная масса электрона, k - постоянная Больцмана. Величина δ мала: так, для Ge $\delta = 10^{-2}$, для InSb $\delta = 10^{-3}$. При этом время τ_T может составлять $\tau_T \approx 10^{-9}-10^{-11}$ с при $v_e \approx 10^{11}-10^{13}$ см $^{-1}$. Такие показатели времени установления представляют интерес для создания устройств плазменной электроники.

Рассмотрим простой случай модуляции пучка СВЧ волн частоты ω , падающей под углом на пластинку полупроводника n-типа. Диэлектрическая проницаемость полупроводника может быть представлена в виде: $\epsilon = R+iI$

$$R = \epsilon_L - \frac{V}{1+S^2} \quad I = \frac{V \cdot S}{1+S^2} ; \quad S = \frac{v_e}{\omega} \quad V = \frac{\Omega^2}{\omega^2} , \quad (5)$$

где:

Ω - Ленгмюровская частота электронов.

При этом температурная зависимость величин R и I может быть представлена через частоту столкновений [1,2] в безразмерной форме:

$$S/Ge = S_0 \sqrt{f} \quad S/InSb = \frac{S_0}{\sqrt{f}} , \quad (6)$$

где параметр f характеризует температуру электронов:

$$f = \sqrt{\frac{T_e}{T_{e_0}}} . \quad (7)$$

Комплексные коэффициенты отражения R_S и R_p , соответствующие s- и p-поляризациям, могут быть записаны через величины (5) в виде (4):

$$R_S = \frac{\cos \alpha - \sqrt{R + iI - \sin^2 \alpha}}{\cos \alpha + \sqrt{R + iI - \sin^2 \alpha}} = |R_S| e^{i\varphi_S} ; \quad (8)$$

$$R_p = \frac{(R+iI)\cos\alpha - \sqrt{R+iI - \sin^2\alpha}}{(R+iI)\cos\alpha + \sqrt{R+iI - \sin^2\alpha}} = |R_p| e^{i\phi_p}. \quad (9)$$

Температурная зависимость коэффициента отражения по интенсивности $|R_s|^2$ показана на рис. 1.

Коэффициент прохождения волны через слой такого полупроводника также зависит от температуры. Так, для слоя толщины d коэффициент прохождения по интенсивности k составляет

$$k = (1 - |R_s|^2) \cdot e^{-\frac{d}{L_x}}, \quad (10)$$

где: L_x – характеристическая длина затухания: $L_x = \frac{c}{\omega\chi}$.

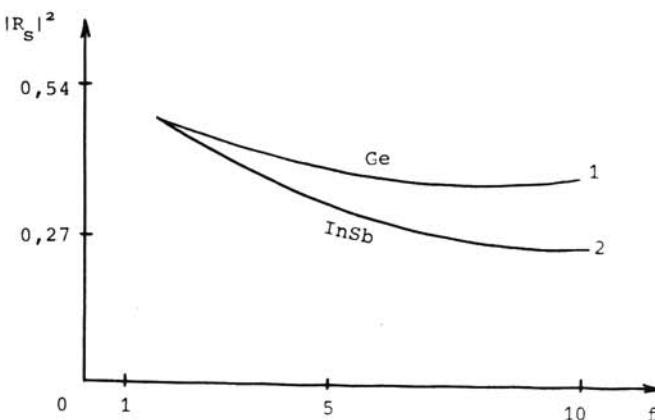


Рис. 1. Зависимость модуля коэффициента отражения $|R_s|^2$ от электронной температуры полупроводниковой плазмы для s-поляризованной волны

Температурная зависимость декремента затухания χ показана на рис. 2.

Проанализируем влияние внешнего магнитного поля на процессы взаимодействия миллиметровых радиоволн с полупроводниковой плазмой. Влияние магнитного поля сильно усложняет угловую и частотную зависимость отражения. Рассмотрим простой случай, соответствующий нормальному падению волны на слой полупроводника, параллельный магнитному полю, в области частот вблизи гирорезонанса. Расстройку резонанса удобно характеризовать параметром:

$$X_0 = \frac{1 - \sqrt{U}}{S_0}, \quad U = \frac{\omega_H^2}{\omega^2}, \quad (12)$$

где ω_H – гирочастота электронов. Вблизи резонанса ($\sqrt{U} \rightarrow 1$) компоненты тензора диэлектрической проницаемости полупроводника можно представить

$$\text{в виде: } \epsilon_{\perp} = \epsilon_L - \frac{V \cdot X_0}{2S_0} \cdot \frac{1}{X_0^2 + S_0^2},$$

$$\epsilon_{||} = \epsilon_L - \frac{V}{1+S^2} + \frac{iVS}{1+S^2}; \quad \epsilon_{\wedge} = -\frac{V}{2(X_0^2 + S_0^2/S_0^2)} \left[\frac{iX_0}{S_0} - S \right]. \quad (13)$$

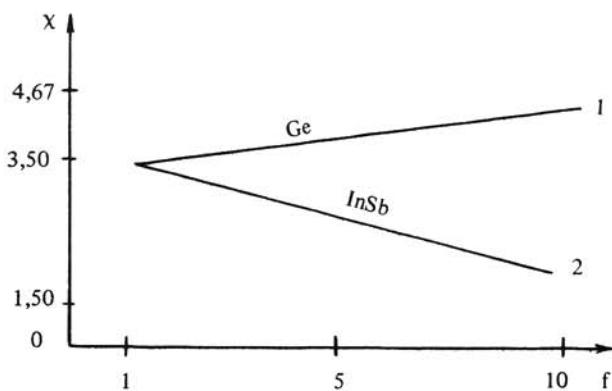


Рис. 2. Температурная зависимость коэффициента поглощения χ при нормальном падении

При нормальном падении волны комплексный коэффициент преломления $n + i\chi$ различен для волн, поляризованных вдоль (ϵ_{\parallel}) и поперек (ϵ_{\perp}) магнитного поля

$$(n + i\chi)_{\parallel}^2 = \epsilon_{\parallel}; \quad (n + i\chi)_{\perp} = \epsilon_{\perp} - \frac{\epsilon_{\perp}^2}{\epsilon_{\parallel}}. \quad (14)$$

Подставив в (14) компоненты тензора ϵ (13), находим n и χ , подставляя затем их в (8) и (10), вычисляем коэффициенты отражения и прохождения волн. При этом разница в коэффициентах отражения и прохождения для компонент E_{\parallel} и E_{\perp} приведет к изменению поляризации отраженной и прошедшей волн. Характеризуя поляризацию углом $\operatorname{tg} \mu = \frac{E_{\parallel}}{E_{\perp}}$ наклона электрического вектора волны к магнитному полю, получим для отраженной волны:

$$\operatorname{tg} \mu = \operatorname{tg} \mu_0 \left| \frac{R_{\perp}}{R_{\parallel}} \right|. \quad (15)$$

Аналогично для прошедшей волны:

$$\operatorname{tg} \mu = \operatorname{tg} \mu_0 \sqrt{\frac{1 - |R_{\perp}|^2}{1 - |R_{\parallel}|^2}} \cdot e^{-\frac{\omega d}{c} (\chi_{\perp} - \chi_{\parallel})}. \quad (16)$$

Следует подчеркнуть, что магнитное поле приводит к резкому изменению отражательных свойств слоя полупроводника и без нагрева электронов. Так, для слоя InSb с параметрами $N_e = 10^{15} \text{ см}^{-3}$, $\epsilon_{\perp} = 15,8$ для волны с $\lambda = 1 \text{ мм}$, $S_0 = 0,1$, $\chi_0 = 0,3$ при постоянной температуре $f=1$ получим, что

отношение составляет $\left| \frac{R_{\perp}}{R_{\parallel}} \right| = 2,1$. В этом случае угол μ при отражении увеличивается, а вектор \vec{E} поворачивается "от магнитного поля". В проходящей волне вектор \vec{E} может повернуться "к магнитному полю", так как

компонента E_1 поглощается сильнее, чем $E_{||}$. Так, в рассматриваемом примере $\chi_{||} = 0,2$, а $\chi_1 = 13,9$ при невозмущенной температуре ($f = 1$) угол равен

$$\operatorname{tg} \mu = \frac{\operatorname{tg} \mu_0}{2} \cdot 1 - \frac{\omega d}{c} (\chi_1 - \chi_{||}),$$

экспоненциальный множитель при толщине пластинки $d = 5 \mu$ составляет 0,6, т.е. $\operatorname{tg} \mu = 0,3 \operatorname{tg} \mu_0$. Таким образом, наложение магнитного поля ведет к различной поляризации отраженной и прошедшей волны.

Совместная модуляция электронной температуры и магнитного поля расширяет возможности контролируемой перестройки СВЧ радиоволн, взаимодействующих с полупроводниковой плазмой.

Л и т е р а т у р а

1. С м и т Р. Полупроводники / Пер. с англ., 2-е изд. - М., 1982.
 2. А н с е л ь м А.И. Введение в теорию полупроводников. - М., 1978.
 3. Г и н з б у р г В.Л. Распространение электромагнитных волн в плазме. - М.: Наука, 1960.
 4. Л а н д а у Л.Д., Л и ф ш и ц Е.М. Электродинамика сплошных сред. - М.: Физматгиз, 1959.
-